

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2023 年 12 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观</p> <p><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>12 月 07 日 16:00-17:00</p> <p>重庆渝富、中信证券、花旗银行、中银国际、国信证券、平安证券、申万宏源、中邮证券、信达证券、海通证券、中金证券、国海电子、瑞银证券、吕梁小金地、旌安投资、西南证券、华能贵诚信托、首钢基金、银河证券、西证股权投资、广东璟诚私募、华泰证券、百联商投、元昊投资、君和资本、蜂巢基金、淳厚基金、国新投资、重庆环保产业私募</p> <p>12 月 13 日 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:30-14:30, 15:00-16:00</p> <p>Ishana Capital、东方证券、华泰柏瑞、华安基金、鹏扬基金、浦银安盛、富国基金、博时基金、摩根基金、景顺长城</p> <p>12 月 20 日 13:00-14:00</p> <p>易米基金、上海至顺资产、国信弘盛私募、朱雀基金、南京天奥投资、前海鸿富、启泰私募、上海峰境基金、华泰柏瑞、上海永望资管、海宸投资、西部证券、长安基金、青骊投资、上海昱奕资产、于翼资产、华西银峰投资、兴银基</p>

	金、龙航资管、麒辰投资、上海鑫岚投资、上海留仁资产
时间	12月07日 16:00-17:00, 12月13日 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:30-14:30, 15:00-16:00 12月20日 13:00-14:00
地点	重庆、上海、深圳
上市公司接待人员姓名	李虹 华润微电子执行董事、总裁 吴国屹 华润微电子执行董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室副主任
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请公司总结一下2023年并展望2024年？</p> <p>答：2023年对于中国半导体是极具挑战的一年，从2022年5月份开始行业进入调整周期，2023年四季度全球半导体销售规模实现同比、环比正增长，说明行业处于企稳阶段。回顾2023年，公司多个重点项目同时发力，重庆12吋聚焦功率器件，爬坡进度按计划进行；重庆先进功率封测基地在模块、面板级等先进封装工艺上实现技术突破；深圳12吋聚焦功率集成电路、模拟及数模混合电路、MCU等。这些项目将为公司长期的发展打下坚实基础。</p> <p>从终端领域看，各领域的回升有所不同，其中新能源特别是汽车的智能化、电动化将会给芯片带来很大机会。目前看汽车电子整体需求较为旺盛，随着国内新能源汽车渗透率的不断提高，未来中国市场将持续放大。公司产品与方案板块下游终端应用中，公司整体泛新能源领域（车类及新能源）占比已经达到39%，公司将在产品上持续发力，抓住中国巨大的市场机会，不断做优做大做强。</p>

问题二：公司此前整建制引入安全 MCU 团队，此次发布的安全 MCU 新品有哪些独特的技术特性或优势？产品的下游应用场景及未来规划有哪些？

答：公司安全 MCU 产品的优势包括高安全等级、大存储空间、强运算能力、多通用接口、全产业链可控、整体解决方案。下游应用主要有智能穿戴、数字钥匙、智能表器、智能家居、智能交通、工业互联网智能终端、高价值资产的安全认证方案等。未来安全 MCU 将继续围绕市场规模大、技术门槛高、国家战略需求强的应用领域，聚焦技术创新痛点难点，持续进行产品布局。

问题三：请问公司 MOSFET 目前产品结构及未来的规划？

答：在公司 MOSFET 产品中，中低压产品占比 60%，高压产品占比 40%。其中，中低压产品以 SGT MOS 为主，高压产品中 SJ MOS 比例持续扩大。SGT 及 SJ 在 MOSFET 的营收占比超过 60%。

问题四：公司此次发布的光电传感器新产品如何应对温度、湿度、光照等环境因素的影响？

答：从温度、光照方面而言，可通过四种方式应对：一是较宽的工作温度范围；二是提高材料的耐温特性；三是增大芯片面积；四是调整封装形式。

从湿度方面而言，可通过三种方式应对：一是提高潮敏等级，二是优化支架材料，三是增强镀层致密性。从整体产品设计方面，使产品更具高性能及可靠性。

问题五：请问如何展望传感器未来的收入贡献？

答：公司在传感器领域布局早、能力强，兼备 6 吋及 8 吋制造能力。近年来，公司采用自主研发与合作研发相结合的模

式，具有较强的研发能力并拥有丰富的产品系列，成功导入国内重点客户。未来传感器也将成为公司重要的业绩增长点。

问题六：请问公司如何看待目前公司的核心竞争力以及如何抓住未来的机遇与挑战？

答：公司发展历经 40 年底蕴深厚，从自主研发、客户积累、生产制造、质量管理、封装测试等方面均能体现出公司强劲的综合竞争力。过去几年，公司一方面通过两江三地战略布局，另一方面持续推进专业化整合，在周期调整阶段保持战略定力不摇摆。

问题七：请问公司对于 IGBT 的产品规划？

答：产品规划上，一是从 6 吋产线升级到 8 吋产线，并进一步加大 12 吋 IGBT 工艺技术和产品研发投入；二是 IGBT 模块产品规模上量，模块占比不断增加，三是加大 IGBT 产品在工控和汽车电子方面的应用，未来 IGBT 产品仍会保持高速增长。

问题八：请问公司 BCD 工艺特色表现在哪些方面？

答：BCD 工艺是公司专注研发、产业化布局的工艺平台，具备 6 吋、8 吋量产能力，目前正在进行 12 吋预研，工艺处于国内领先水平。公司未来也将持续聚焦高端产品、高端领域，进一步夯实高端实力，与合作伙伴共创互利。

问题九：请问公司未来代工业务的规划？

答：公司是中国晶圆代工的先驱者，代工的商业模式由公司旗下的华润上华开启先河。公司将对标三星、英特尔等知名企业，在产能布局上做好代工业务的规划，推动自有产品 IDM 模式及代工业务共同发展。

问题十：公司碳化硅相比新进入者来说，是否具有成本优势？

产品是否导入车企？

答：公司碳化硅产品成本优势体现在两个方面：其一，初始投资比新进入者具有优势，只需要购买专用设备，其他机台与6吋硅基产线共用；其二，跟目前较为庞大的硅基生产线共线运营，碳化硅与硅基共同分摊成本，具有较大的成本优势。目前已成功导入国内头部车企，优势持续显现。

问题十一：请问公司车规级产品的进展？

答：公司 SGT MOS、SJ MOS、IGBT、SiC MOS 等系列化车规级产品及模块产品，已向头部整车厂商及汽车零部件 Tier1 供应商进行供货；同时与知名车企组建联合创新实验室，聚焦安全 MCU 等产品研发。近两年，公司上车的产品超亿颗。

问题十二：请问公司明年的业绩展望？

答：公司 2024 年营业额目标是在今年的基础上保持增长。

问题十三：请问 12 吋较 8 吋具有哪些优势？

答：从制造能力来看，12 吋具有更高的工艺先进性及产品一致性；从成本控制来看，更能有效利用生产线的资源，从而降低了单个芯片的成本；从公司发展布局来看，重庆 12 吋聚焦功率器件产品，深圳 12 吋聚焦功率 IC，最大程度提高运营效率。

问题十四：请问公司第三代半导体的发展现状？

答：公司目前碳化硅和氮化镓晶圆线均已稳定量产，碳化硅 JBS、碳化硅 MOS 能比肩国际先进水平，在工业和汽车领域为较多标杆客户批量出货。

	<p>问题十五：请问公司在三代半导体的布局有哪些？</p> <p>答：公司对上游材料、自身的器件制造以及下游的市场应用端都有着长远的规划和布局，比如通过投资入股、收购兼并、产业协同等方式来完善和强化产业链。</p> <p>问题十六：请问公司库存情况？</p> <p>答：公司目前在制品和产成品的库存在 2 个月左右，处于合理范围。</p> <p>问题十七：请问公司晶圆制造产能内部自用和外部客户代工是如何分配的？</p> <p>答：公司 6 吋产线自用和外部客户代工比例基本各 50%；8 吋线有 2 条，无锡 8 吋线 70%以上产能用于外部客户代工，重庆 8 吋线全部用于自有产品；重庆 12 吋线全部自用。</p> <p>问题十八：请问目前公司晶圆制造产能利用率如何？</p> <p>答：公司受益于 BCD 特色工艺优势、客户基础稳定以及 IDM 商业模式调节等因素，公司目前 8 吋产能利用率保持在 90%以上，6 吋保持在 95%以上，重庆 12 吋处于产能爬坡阶段。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月